

证券代码：605358

证券简称：立昂微

公告编号：2023-052

债券代码：111010

债券简称：立昂转债

杭州立昂微电子股份有限公司 2023年半年度业绩预减公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 杭州立昂微电子股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,500.00万元至18,500.00万元，同比减少67.21%至63.24%。

● 预计归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,600.00万元至5,600.00万元，同比减少89.88%至87.68%。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2023年1月1日至2023年6月30日。

（二）业绩预告情况：同比下降

1、经财务部门初步测算，预计2023年半年度实现归属于上市公司股东的净利润为16,500.00万元至18,500.00万元，与上年同期相比，将减少33,823.13万元至31,823.13万元，同比减少67.21%至63.24%。

2、归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4,600.00万元至5,600.00万元，与上年同期相比，将减少40,862.50万元至39,862.50万元，同比减少89.88%至87.68%。

（三）本期业绩预告数据未经注册会计师审计。

二、上年同期业绩情况

(一) 归属于上市公司股东的净利润：50,323.13万元；归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润：45,462.50万元。

(二) 每股收益：0.74元/股。

三、本期业绩预减的主要原因

(一) 主营业务影响

公司上半年预计实现营业收入总额13.42亿元，相比去年同期下降14.2%。从季度来看，第二季度预计实现营业收入总额7.10亿元，环比增长12.3%。

半导体硅片业务：上半年预计实现主营业务收入7.55亿元，相比去年同期下降18.5%。从季度来看，第二季度预计实现主营业务收入4.02亿元，环比增长14%。

半导体功率器件芯片业务：上半年预计实现主营业务收入5.38亿元，相比去年同期下降10.7%。从季度来看，第二季度预计实现主营业务收入2.80亿元，环比增长8.4%。

化合物半导体芯片业务：上半年预计实现营业收入总额0.39亿元，相比去年同期增长30.6%。从季度来看，第二季度预计实现营业收入总额0.23亿元，环比增长41.9%。

影响营收及利润变动的因素分析如下：

半导体硅片业务：公司部分募投项目自2022年6月开始陆续转产，相应的折旧费用等固定成本增加较多，但是自2022年下半年以来，受消费电子市场下滑影响，硅抛光片产能利用率下降，部分硅片产品价格有所下调。由于受经济疲弱影响，衢州基地的12英寸硅片仍处于产能爬坡中；2022年3月份收购了嘉兴金瑞泓，产能处于爬坡过程中。受益于功率半导体需求稳定，公司硅外延片产能利用率充足。

半导体功率器件芯片业务：上半年清洁能源、新能源汽车需求较稳定，公司

的功率器件芯片销售订单饱满，产能利用率维持高位，产销旺盛，相比去年同期销量下降3%，但受部分产品销售价格下调的影响导致毛利率有所下降。

化合物半导体芯片业务：受益于产品技术实现突破，射频芯片验证进度已基本覆盖国内主流手机芯片设计客户，在手订单同比大幅增长，上半年营收同比大幅增长，负毛利率情况有所收窄，亏损有所减少。

公司2022年11月发行33.9亿元面值可转债，按照会计准则的要求本报告期计提了6,236万元的财务费用，影响了业绩。

（二）非经常性损益的影响

公司本报告期内非经常性损益大幅增加，主要是政府补助及确认其他非流动金融资产公允价值变动收益增加所致。

四、风险提示

公司本次预计业绩未经注册会计师审计，且注册会计师未对公司本期业绩预告是否适当和审慎出具专项说明。公司不存在影响业绩预告内容准确性的重大不确定因素。

五、其他说明事项

以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023年半年度报告数据为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

杭州立昂微电子股份有限公司董事会

2023年7月14日